

确认书编号		202301117MT-420-DIP20-HS16F3612W-01									
产品型号		HS16F3612W		封装形式		DIP20L		客户代码		KH0420	
芯片 DIE	芯片型号 Die Type	芯片尺寸 Die Size (um)	焊点尺寸 BPO(um)	焊点最小间距 BPP(um)	铝垫成份 Pad Composition	顶铝层厚度 Aluminium Layer Thickness (um)	焊点下 是否有器件 Circuit Under Pad	减薄 BG	芯片厚度 Die thickness (um)		
A	HS5137	1260*950 (含 60um 划片道)	60*60	/	/	0.8	是	是	280±10		
可靠性要求		散热要求		工作电压		工作电流(A)		工作结温 Tj		焊接温度	
<div></div>											
特殊说明											
BOM 信息						框架示意图		产品成型图			
材料		型号									
焊线直径		焊线 1:20um 铜线									
焊丝数量		焊丝 1:21									
框架规格		DIP20L(2P)铜框架(110*140mil2)									
粘片材料		上芯方式		A:粘片胶粘片							
		二选一	首选	A:导电胶 S210							
			备选								
塑封料		二选一	首选	环保料 EMG-350							
			备选								
拟 制		陈露		研发部审批		工程部经理		公司审批			
日期		2023-01-17		日期		日期		日期			
注：1、产品完成工程试封后，客户端务必进行终端使用环境及电性能测试（如带电老化），考核通过后才能进行量产； 2、客户确认压焊图，无异议请签字回传。											
客户回签及特殊要求											
客户要求及回签											